

BGA/CSP/QFP 三次元・二次元外観検査用ハンドラー

MVI-10 (1枚トレイ供給タイプ)



特 徴

- ・ MVI-10型 IC検査装置は拡張性が高く、小型 (W660×D1,030×H1,850mm) で移動可能 (必要なのは100Vのみ) な、ICチップ (CSP, WLCSP, BGA, QFP等) の2次元および3次元検査装置です。
- ・ JEDEC 1枚トレイ供給タイプで、自動搬送・検査・判別を行うことができます。
- ・ 検査ユニットは、2次元検査または3次元検査のどちらかを選定できます。
- ・ 他の検査装置を連結し、ワークを受け渡し検査させることも可能な拡張性があります。

SHINKO

新光エンジニアリング株式会社

装置概要

本装置は、搭載検査ユニットによりICの2次元外観検査、3次元外観検査、その他の特殊検査に対応可能な、多用途対応ハンドラーです。

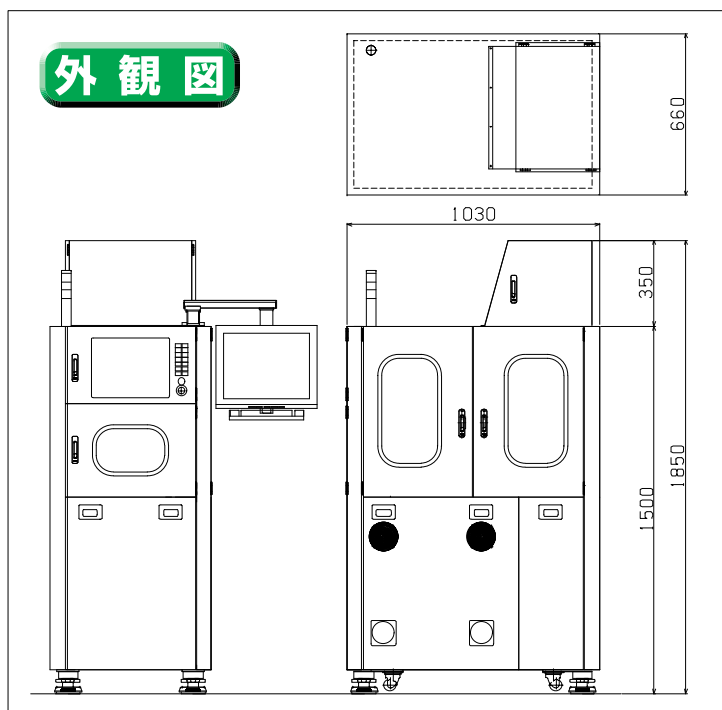
特徴

- ・安価です。
- ・小型軽量で手軽に移動可能です。
- ・100W電源のみ、エア源なしで運転可能です。
- ・検査データ収集ソフトが充実しているため、検査装置として短期間で立上げ可能です。
- ・ハンドラー、検査ステージともACサーボモータ駆動で高速、高精度です。
- ・設計が標準化されて、拡張オプションが取り付け出来ます。

【検査仕様】

検査ユニット	検査項目
2次元外観検査(各社のユニット搭載可能です)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観検査 ・リード検査 ・モールド検査 ・マーク検査 ・方向判別
3次元外観検査(各社のユニット搭載可能です)	<ul style="list-style-type: none"> ・コプラナリティ ・ボール高さ ・PKG反り ・スタンドオフ ・ボール径

外観図



【仕様】

対象物	<ul style="list-style-type: none"> ・QFP □40~7mm ・BGA □50~5mm (オプション) □75~50mm □5~2mm
搬送時間	<ul style="list-style-type: none"> ・供給トレイ→測定ステージ 1sec ・測定ステージ→収納トレイ 1sec (オプション) デバイス反転 1sec トレイ交換 10sec 測定ステージ1→測定ステージ2 1sec
ハンドラー仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドラー X-Y-Z 3軸サーボモータ駆動 ・検査ステージ X-Y-Z 3軸サーボモータ駆動 ・対象トレイ JEDEC
装置サイズ・重量	W660mm×D1,030mm×H1,850mm 450kg
ユーティリティ	電源：AC100V 15A コンプレッサー、真空ポンプ付
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・多段トレイ対応 ・特殊トレイ対応 ・検査ステージ増設対応

SHINKO

新光エンジニアリング株式会社
SHINKO ENGINEERING CO., LTD.

本社工場

〒942-0231 新潟県上越市大字下吉野1706番地12
TEL : (025) 539-1231(代) FAX : (025) 539-1233
Home Page <http://www.shinko-eng.co.jp/>

HEAD OFFICE

1706 OHAZA SHIMOYOSHINO JOETSU-CITY
NIIGATA-PREF 942-0231 JAPAN

販売元

Sales agents